

JEITA 先端半導体パッケージング WG/大阪大学 F3D 実装コンソーシアム共催セミナーの
お知らせ

テーマ「先端半導体パッケージング開発において考慮すべきこと」

皆様

(※bccで配信しております)

平素より大変お世話になっております。

表記しました先端半導体技術講演会を JEITA 先端半導体パッケージング技術 WG、
F3D 実装コンソーシアムの合同主催で開催いたします。

自動車の電動化や自動運転化、或いは HPC 産業展開とカーボンニュートラルなどの
背景において、先端半導体の高度化と WBG パワーエレクトロニクスの市場拡大が加
速されています。今日、これらの市場展開で大きな課題となるノイズへの対処とチップ
レットなど最先端実装技術開発における知財マネジメントの両領域に焦点を当
て、この分野をリードされる先生方に最新動向をご紹介します。

皆様にとりまして興味深い内容と感じますので、幅広いご参加をお待ちしておりま
す。

—記—

1. 題目：「先端半導体パッケージング開発において考慮すべきこと」

共催：JEITA 先端半導体パッケージング技術 WG、大阪大学 F3D 実装コンソー
シアム

2. 日時：2023年1月23日（月）14:00～16:00

3. 場所：Webexによるオンライン開催

参加登録いただいた方には接続方法をご案内いたします。

4. 参加費：無料

今後の同様イベントお知らせをご希望の方々は、事務局へ参加返信をお願いしま

す：F3D加藤 (katoyu@sanken.osaka-u.ac.jp)

5. プログラム：

14:00～ 開会挨拶 大阪大学 F3D 実装協働研究所 所長 菅沼 克昭

14:10～15:00 半導体のノイズについて

神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 研究科長 永田 真 教授

【概要】半導体製品の稠密配置によりノイズ課題が顕在化する。本講演では、半導体チップとアセンブリにおけるノイズ課題に着眼し、不要電波干渉、パワーインテグリティ、そしてサイドチャネル攻撃をキーワードに、多面的な評価と対策の事例を概説する。

15:00～15:50 オープン/クローズ戦略(標準化と知財)について

東京工業大学 オープンイノベーション機構 副機構長 大嶋 洋一 教授

【概要】チップレット分野における特許情報を活用して、当該分野の現状分析を試みます。また、分析結果とコンソーシアムに期待される役割を整理した上で、チップレット分野におけるコンソーシアムを活用したオープンイノベーションエコシステムについて展望します。

15:50～16:00 閉会挨拶

以上.